



「臺日合作需求調查表」-日文版

企 業 情 報				
御 社 名 (※ 必 填)	(中) 廣化科技股份有限公司			
	(英) 3s silicon tech. inc			
U R L	https://www.sss-tech.com.tw/			
代 表 者	黃文鼎 Wenting Huang	海 外 取 引 實 績	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有：	
<b>1. 企業紹介(※必填)</b>				
廣化科技股份有限公司設立於 87 年 2 月 4 日，以高功率半導體元件(Power Device)封裝設備之研發製造為主，並以自我品牌名稱廣化-3S，來行銷全球。總公 司設於台灣新竹縣，在中國上海設有子公司。主力產品固晶機專用於各類電力電子 (Power Electronics)晶片封裝。				
<b>2. 事業内容 (得意技術、強み) (写真含むも良い) (※必填)</b>				
目前主要產品為銅跳線固晶機(Clip Die Bonder)含固晶機(Die Bonder)、銅跳線 機(Clip Attach)、迴錫爐(Snap reflow oven)及真空迴錫爐(Vacuum reflow oven)等。由 於廣化的銅跳線式固晶機相較於傳統錫線機(Wire bonder)在接觸電阻及封裝尺寸 上擁有更顯著的優勢，已被廣泛使用在高電流(High Power Electronics)器件的封裝 上，在大中華地區 Diode 市場享有 70%以上的市佔率。此外，由於客戶對封裝產品 品質日益嚴苛的要求，低封裝氣泡率(Low void rate)的封裝製程，是進軍高階產品 如車用電子、高規格工業產品的必要條件。廣化公司與客戶合作驗證多年之真空迴 錫爐 (Vacuum reflow oven)，已成為封裝業界高可靠度電力電子產品封裝之最佳選 擇，無論是 Diode, Power Mosfet, IGBT 及 IPM 均可運用廣化的真空迴錫爐。				
<b>3. 商談希望内容の説明(※必填)</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> 販売： <input type="checkbox"/> 購入： <input type="checkbox"/> 技術提携： <input type="checkbox"/> 共同で第三国展開：				
※ 連 絡 担 当 者	NAME	Wenting Huang	Job Title	Assistant Vice President
	TEL	+886 976295256	FAX	
	E-mail	Wenting.huang@sss-tech.com.tw	Language	<input type="checkbox"/> 日本語 <input checked="" type="checkbox"/> 英語

★請優先以日文填寫。

★請勿將此表格轉為 PDF 檔，填寫完畢後將原檔回傳至指定信箱：[haru@teeia.org.tw](mailto:haru@teeia.org.tw) 或 [miyabi@teeia.org.tw](mailto:miyabi@teeia.org.tw)，謝謝您的合作！